

露笑科技股份有限公司

关于新增设立募集资金专项账户并授权签订三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加募集资金专项账户并授权签订三方监管协议的议案》，公司同意子公司合肥露笑半导体材料有限公司（以下简称“合肥露笑”）在平安银行股份有限公司上海分行增设一个募集资金专项账户，用于实施募投项目“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”资金的存储、使用和管理。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]1132 号文），核准公司非公开发行不超过 481,101,397 股新股。公司实际发行人民币普通股 319,334,577 股，发行价格为 8.04 元/股，募集资金总额为 2,567,449,999.08 元，减除发行费用后，募集资金净额为人民币 2,512,526,098.54 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 30 日到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 332C000373 号《验资报告》验证。

二、募集资金专户设立及募集资金监管协议的签订情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》中相关条款的规定，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》，并设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），具体情况如下：

序号	项目名称	户名	开户行	账号
1	募集资金总账户	露笑科技股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州庆春支行	8110801012502477211
2	第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目	合肥露笑半导体材料有限公司	中国农业银行股份有限公司诸暨市支行	19531201040013486
3	第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目	合肥露笑半导体材料有限公司	浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行	3371020310120100270168
4	第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目	合肥露笑半导体材料有限公司	平安银行股份有限公司绍兴分行	15116118118883
5	第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目	合肥露笑半导体材料有限公司	中国银行股份有限公司诸暨支行	371481316261
6	大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目	合肥露笑半导体材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行	85050078801000001275

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 1 日刊登在巨潮资讯网上的《关于设立募集资金专户并签订监管协议的公告》（公告编号：2022-049）。

三、本次新增设立募集资金专项账户情况

为满足子公司合肥露笑“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”的需要，结合公司实际情况，进一步提高公司募集资金使用效率，规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于增加募集资金专项账户并授权签订三方监管协议的议案》，子公司合肥露笑在平安银行股份有限公司上海分行增设一个募集资金专项账户，用于实施募投项目“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”资金的存储、使用和管理。同时授权公司管理层及其授权人士具体办理募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等事宜。公司将尽快与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日